

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3925843

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
YOUNGWOON KWON	06/10/2016
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	SOLID, INC.
<b>Street Address:</b>	(SOLIDSPACE, SAMPYEONG-DONG) 220, PANGYOYEOK-RO
<b>Internal Address:</b>	BUNDANG-GU
<b>City:</b>	SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO
<b>State/Country:</b>	KOREA, REPUBLIC OF
<b>Postal Code:</b>	463-400
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Application Number:</b>	15106385
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(202)293-7860
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
<b>Phone:</b>	2022937060
<b>Email:</b>	rknight@sughrue.com, sughrue@sughrue.com
<b>Correspondent Name:</b>	SUGHRUE MION, PLLC
<b>Address Line 1:</b>	2100 PENNSYLVANIA AVENUE NW
<b>Address Line 2:</b>	SUITE 800
<b>Address Line 4:</b>	WASHINGTON, D.C. 20037
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	Q227558
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	CHRISTOPHER KNIGHT
<b>SIGNATURE:</b>	/Christopher Knight/
<b>DATE SIGNED:</b>	06/20/2016
This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	
<b>Total Attachments: 3</b>	
source=Q227558CombinedAssignmentwithDeclarationExecuted#page1.tif	
source=Q227558CombinedAssignmentwithDeclarationExecuted#page2.tif	
source=Q227558CombinedAssignmentwithDeclarationExecuted#page3.tif	

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이하 양도인으로 지칭되는 하기 서명 발명자인 본인(들)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

\_\_\_\_\_에 소재한 \_\_\_\_\_(양수인)는(은) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로,

이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그 양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개된 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와 미합중국 코드 제 35장 제§119 항에 의거한 우선권 청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한 모든 그 재발행에 대한 전체 권리, 소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인, 그 승계자 또는 그 양수인에게 발급하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인의 요청할 경우 미국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.

(공인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35 장 제§261 항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

본인은 아래 서명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:

- 첨부 출원 또는
- 미합중국 출원 또는 PCT  
국제출원 번호: \_\_\_\_\_  
출원일: \_\_\_\_\_ (확인 번호: \_\_\_\_\_)

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, SOLiD, INC. of (Solidspace, Sampyeong-dong) 220, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States application when called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States Application or PCT International Application Number \_\_\_\_\_ filed on \_\_\_\_\_ (Confirmation No. \_\_\_\_\_).

The application is entitled:

OPTICAL RELAY SYSTEM AND METHOD FOR SETTING IDENTIFICATION INFORMATION OF REMOTE DEVICE IN OPTICAL RELAY SYSTEM

### Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울러 이해합니니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.56 항에 규정된 바에 따라, 특허성의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

#### STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature

Date



March 17, 2014

**NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:**

단독 혹은 최초 발명자의 성명

Given Name (first and middle [if any])

이름 (성씨 는 제외)

Youngwoo


Family Name or Surname

성 (姓)

KWON

Inventor's signature

발명자의 서명



Date

일자

June 10, 2016

Residence:

거주지:

Seoul, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소:

c/o SOLiD, INC., (SolidSpace, Sampyeong-dong) 220, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Korea